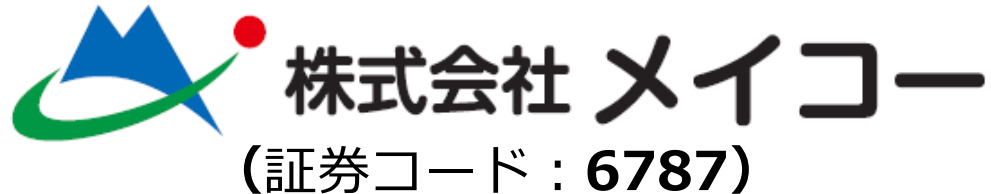


2016年度

決算説明会資料

2017年5月19日



1

2016年度 実績

2

2017年度 計画

3

基板業界動向

4

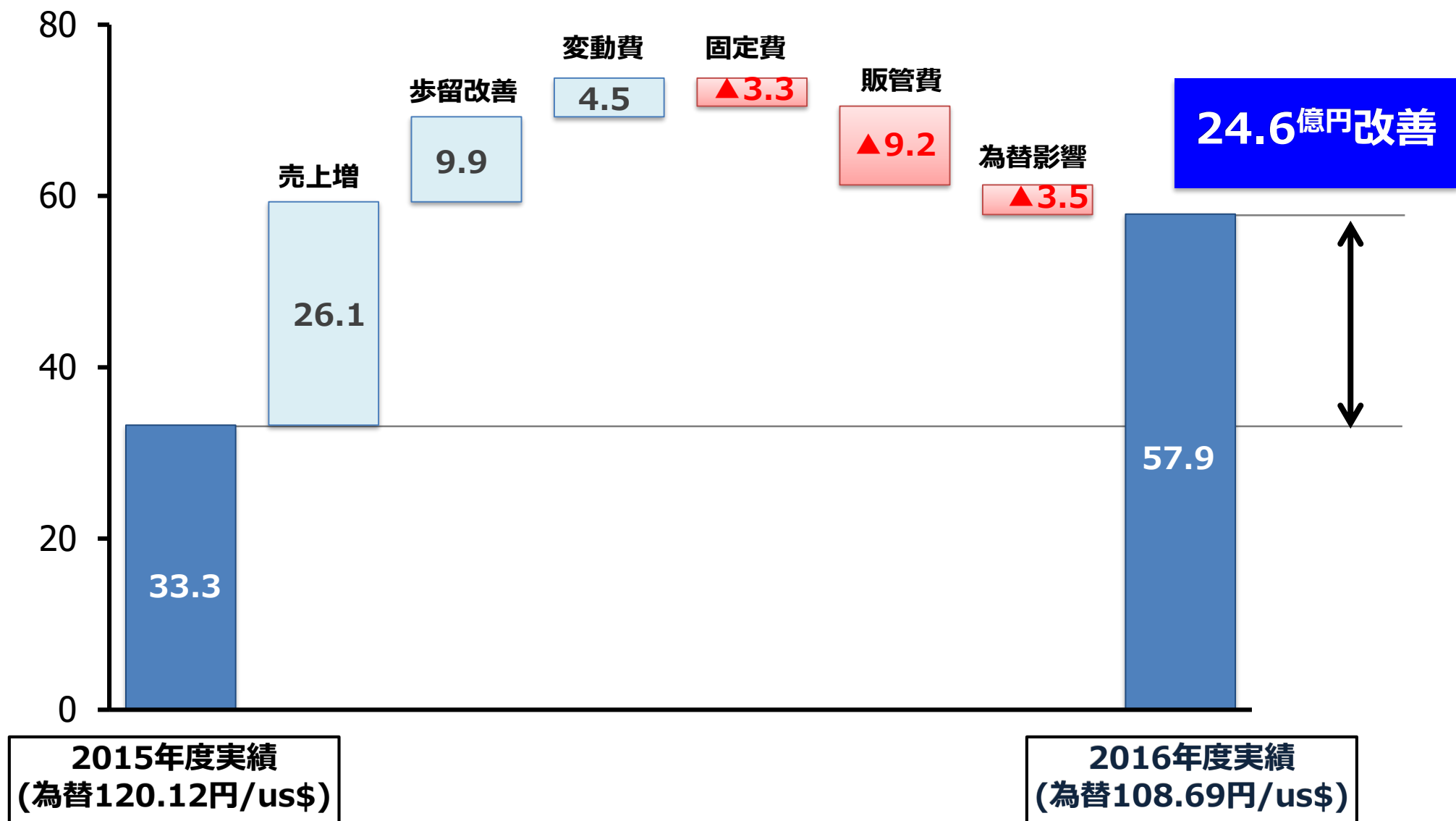
技術ロードマップ

2016年度 連結実績

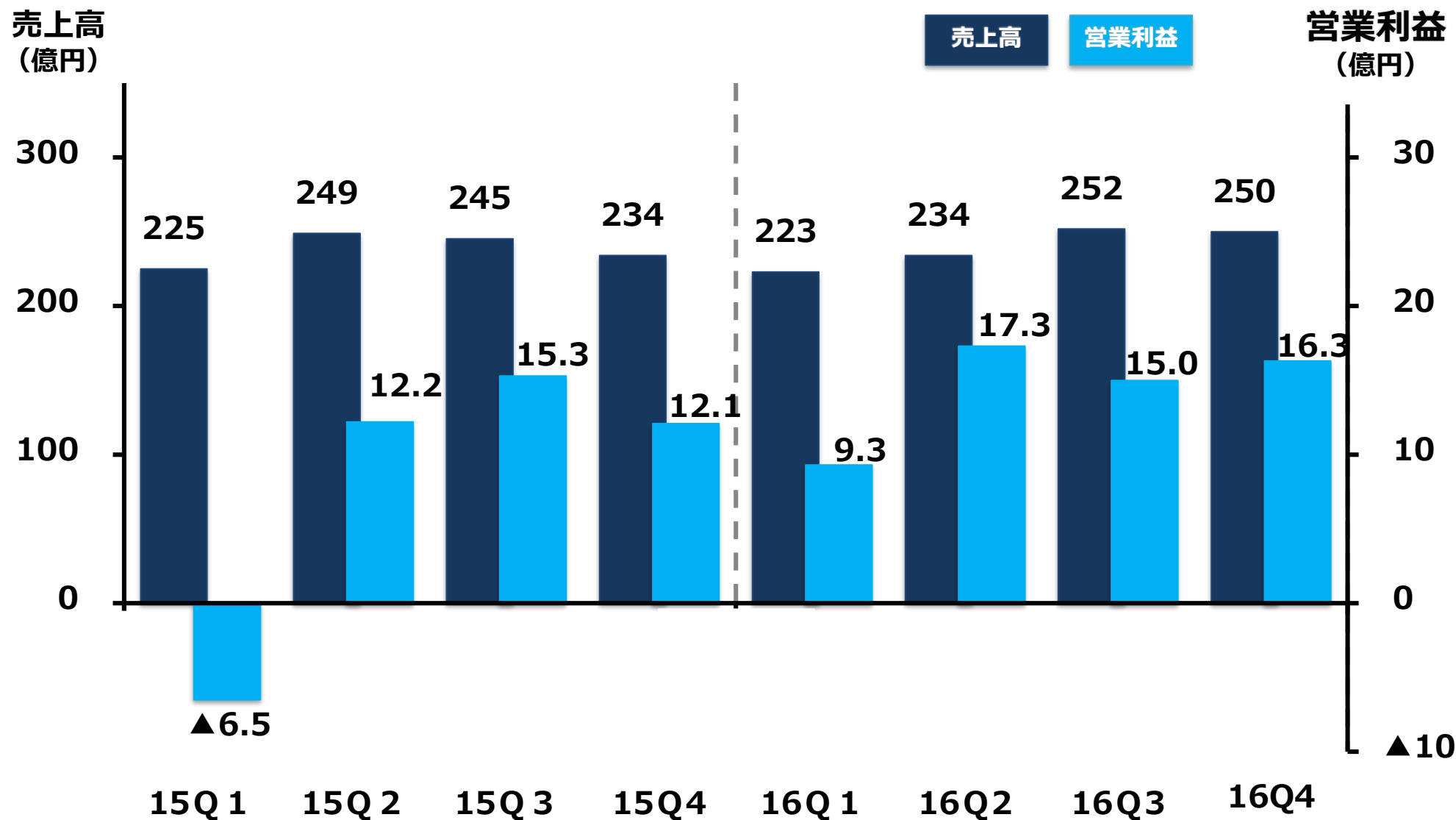
(単位：億円)

	2015年度 実績	2016年度 実績	前年比	
			増減額	増減率
売上高	952.9	959.1	+6.2	0.7%
営業利益	33.3 3.5%	57.9 6.0%	+24.6	73.9%
経常利益	▲4.9 ▲0.5%	29.8 3.1%	+34.7	-
当期純利益	▲112.5 ▲11.8%	17.7 1.8%	+130.2	-
期中平均為替レート (円 / USD)	120.12	108.69		

営業利益増減分析 ～ 前年比



売上高と営業利益推移



2016年度 海外工場実績

(単位：億円)

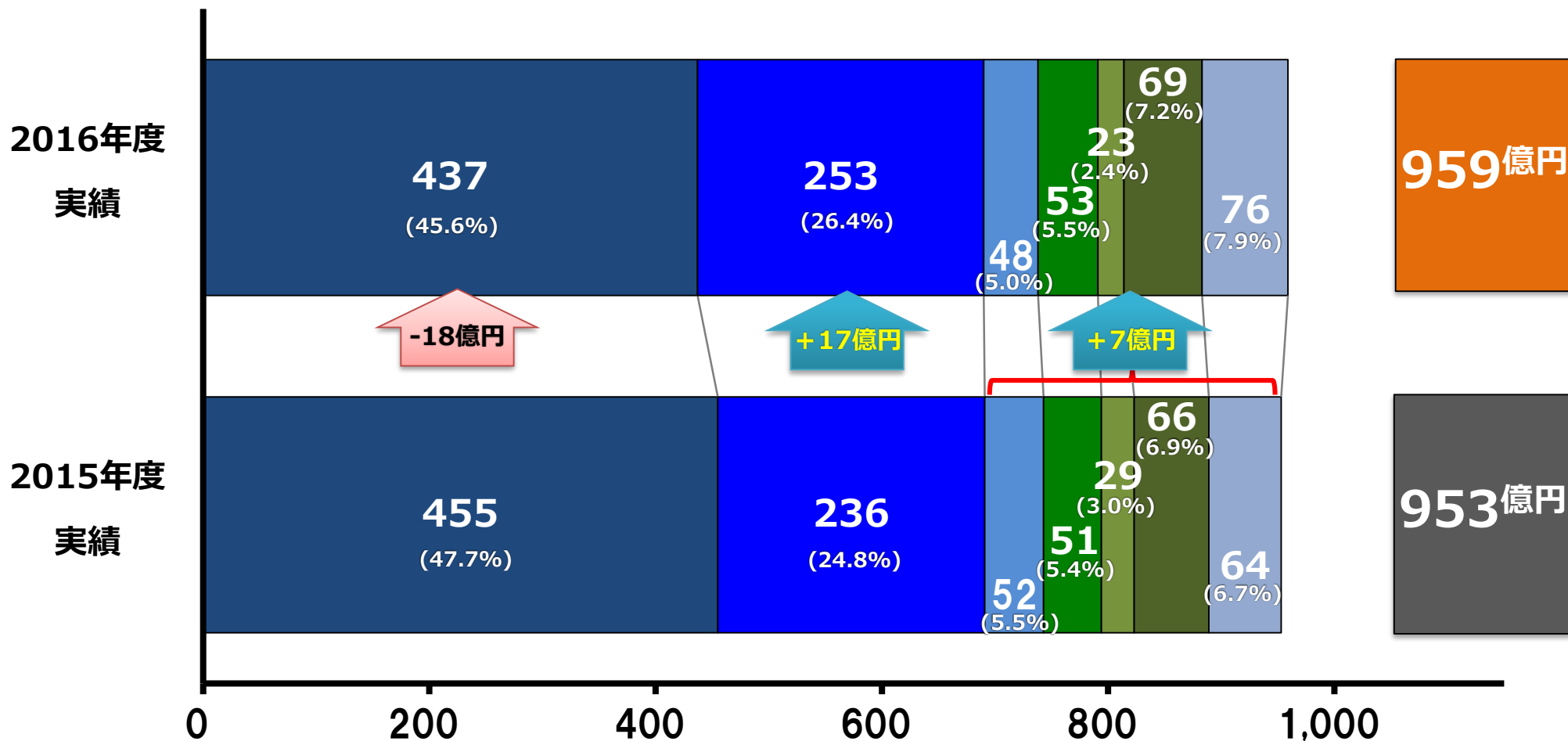
		2015年度 実績	2016年度 実績	前年比	
				増減額	増減率
広州工場	売上高	319	284	-35	-11.0%
	営業利益	17 5.3%	17 6.0%	0	0.0%
武漢工場	売上高	320	358	+38	11.9%
	営業利益	5 1.6%	21 5.9%	+16	320.0%
ベトナム 工場	売上高	166	192	+26	15.7%
	営業利益	9 5.4%	20 10.4%	+11	122.2%
期中平均為替レート (円/USD)		120.12	108.69		

※ ベトナム工場はタクトット工場とタンロン工場の連結になります

販売実績 ～ 基板用途別

(単位：億円)

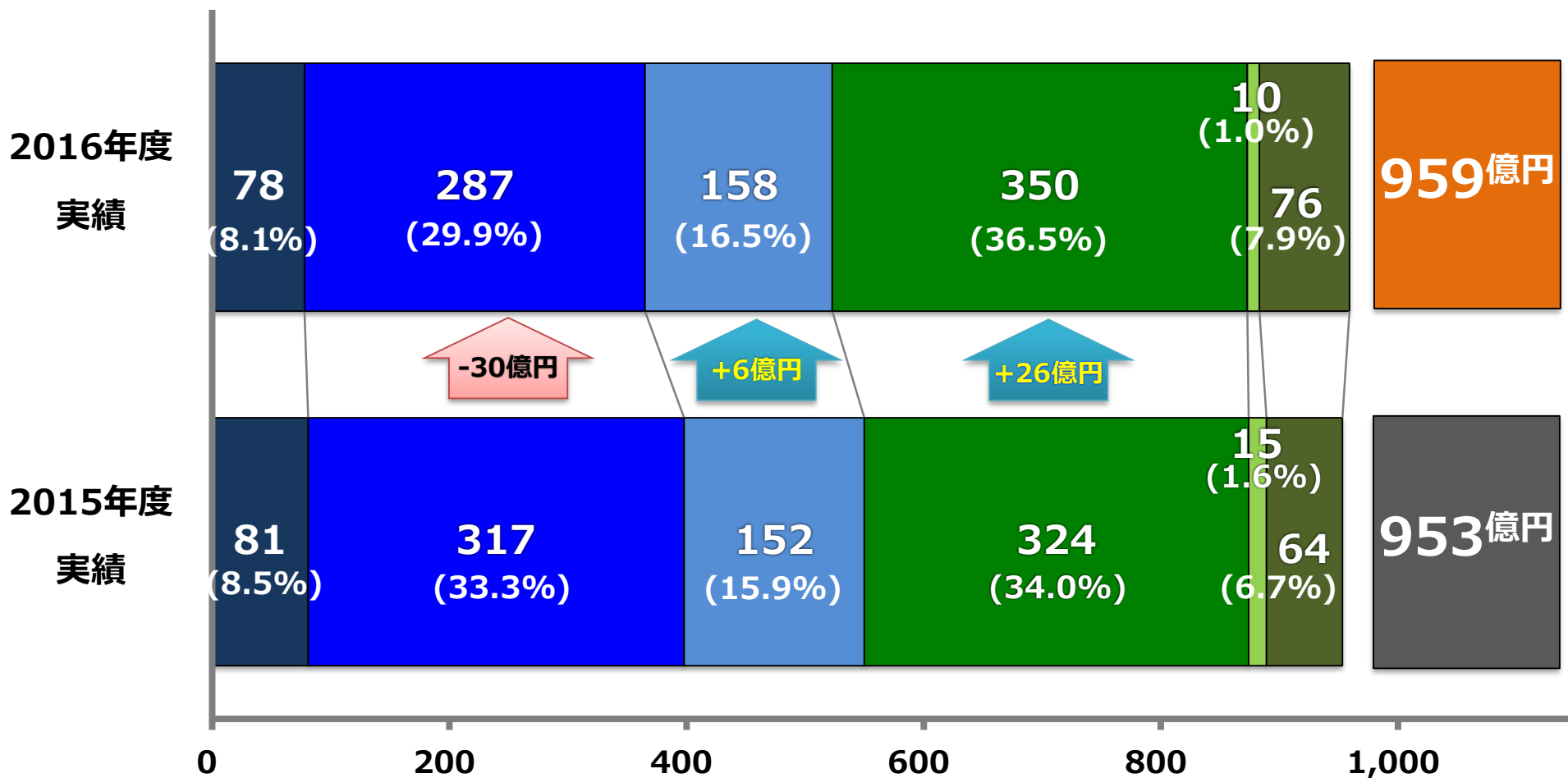
■ 車載 ■ スマートフォン ■ ストレージ ■ 事務機 ■ デジタル家電 ■ その他基板 ■ 基板以外



販売実績 ～ 基板仕様別

(単位：億円)

■ 両面板 ■ 4層板 ■ 6層板以上 ■ ビルドアップ ■ その他の基板 ■ 基板以外



1

2016年度 実績

2

2017年度 計画

3

基板業界動向

4

技術ロードマップ

2017年度（通期）計画 連結業績

（単位：億円）

	2016年度 実績	2017年度 計画	前年比	
			増減額	増減率
売上高	959.1	1,030.0	+70.9	7.4%
営業利益	57.9 6.0%	62.0 6.0%	+4.1	7.1%
経常利益	29.8 3.1%	46.0 4.5%	+16.2	54.4%
当期純利益	17.7 1.8%	36.0 3.5%	+18.3	103.4%
期中平均為替レート (円 / USD)	108.69	110.00		

2017年度（通期）計画 海外工場業績

（単位：億円）

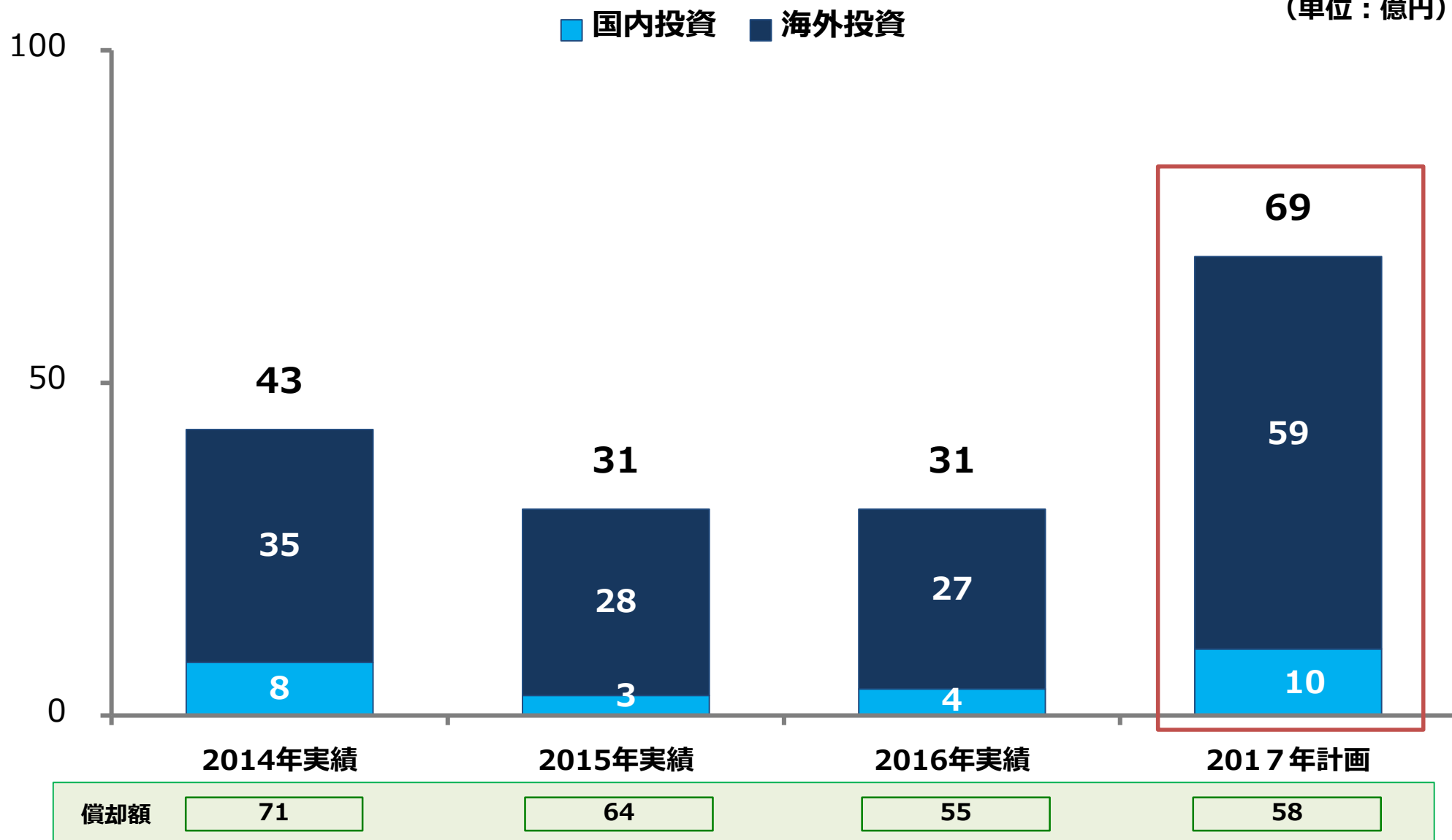
		2016年度 実績	2017年度 計画	前年比	
				増減額	増減率
広州工場	売上高	284	250	-34	-12.0%
	営業利益	17 6.0%	15 6.0%	-2	-11.8%
武漢工場	売上高	358	373	15	4.2%
	営業利益	21 5.9%	22 5.9%	1	4.8%
ベトナム工場	売上高	192	238	46	24.0%
	営業利益	20 10.4%	25 10.5%	5	25.0%
期中平均為替レート（円/USD）		108.69	110.00		

※ ベトナム工場はタクトット工場とタンロン工場の連結になります

設備投資計画

※ 検収ベース

(単位：億円)



1

2016年度 実績

2

2017年度 計画

3

基板業界動向

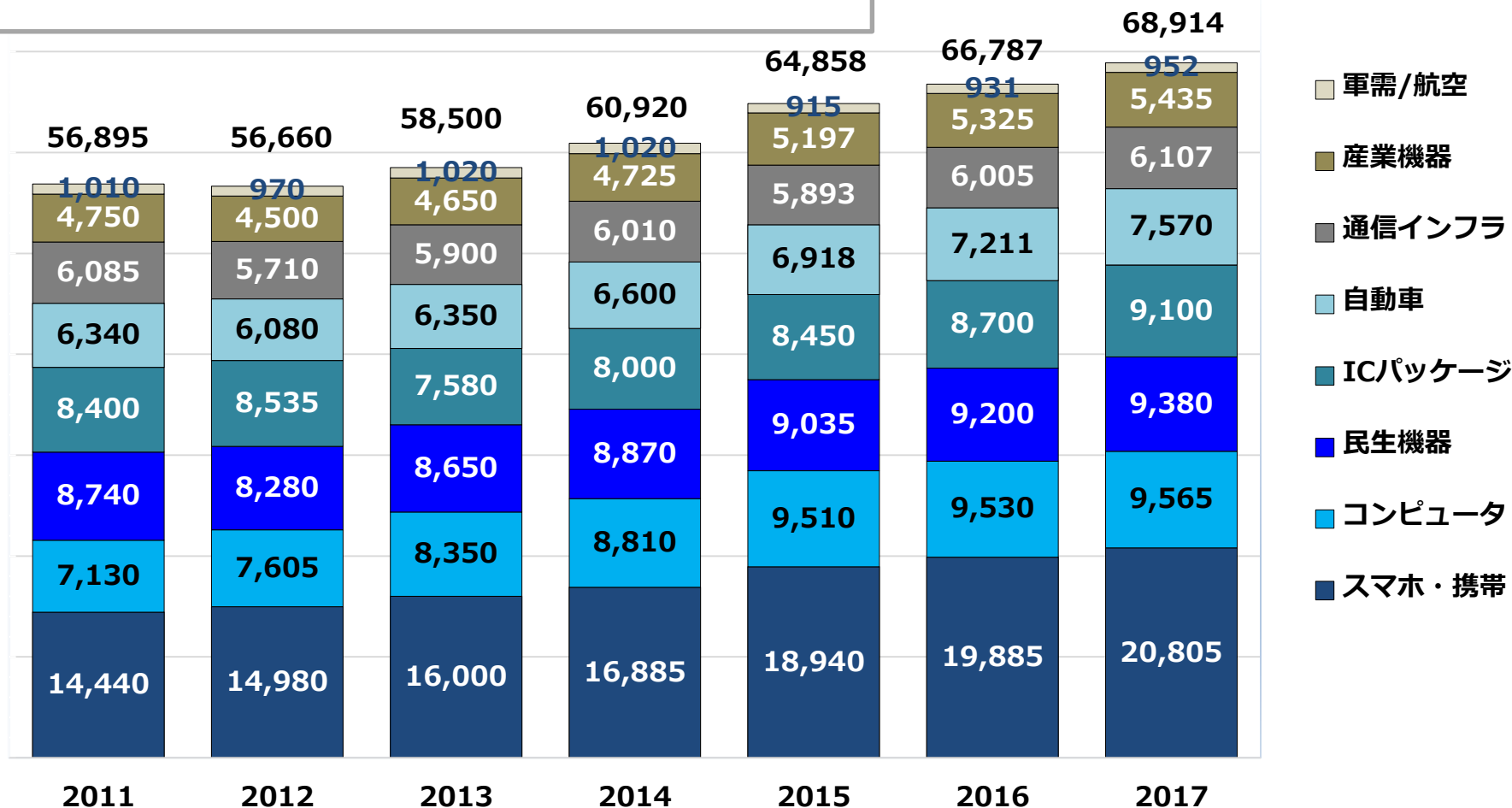
4

技術ロードマップ

基板業界動向 ～ 販売実績・見込

スマートフォン・自動車を中心に拡大傾向が続く

(単位：MUSD)

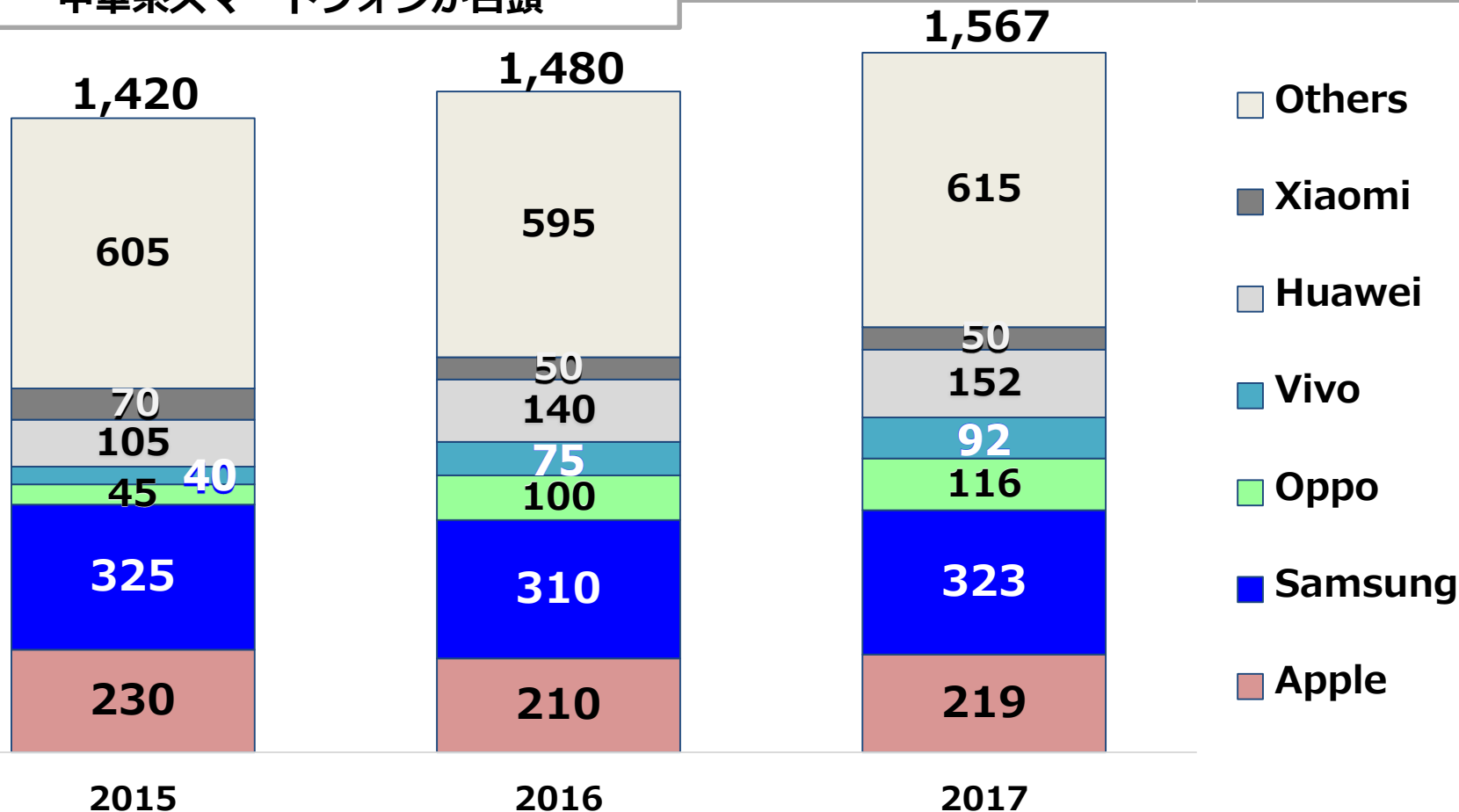


出典：JMS

基板業界動向 ～ スマートフォン

世界市場では、グローバル2強に加えて、中華系スマートフォンが台頭

(単位：百万台)



出典：富士キメラ総研、EMC

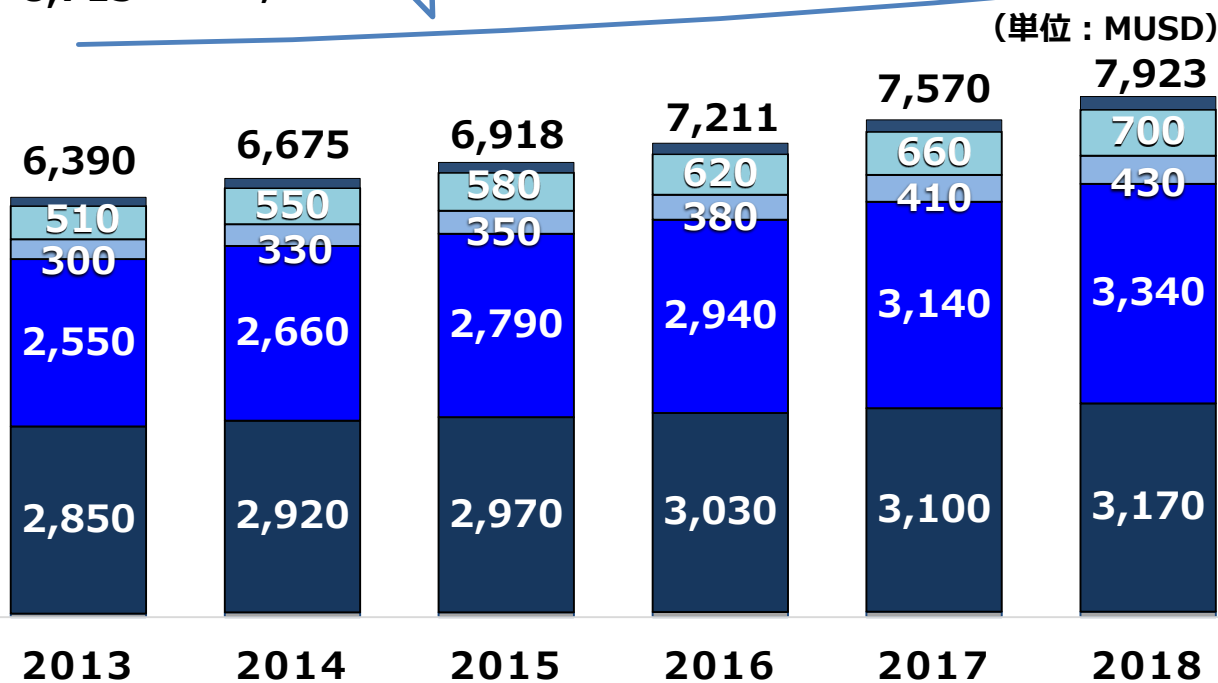
基板業界動向 ~ 車載基板

販売台数を上回るトレンドでプリント基板の採用は増加傾向

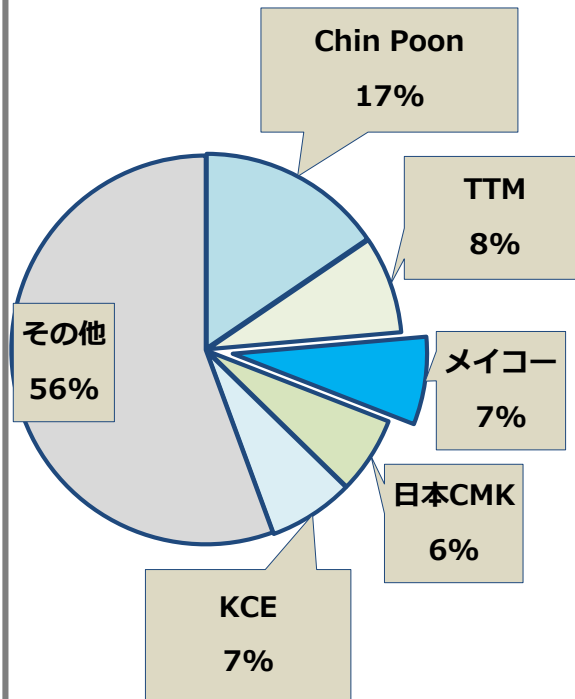
自動車販売台数

(単位：万台)

8,715 8,787 8,928 9,109 9,347 9,633



2016市場シェア
【売上数量ベース(m²)】



■両面 ■多層 ■BU ■FPC&R/F ■その他

出典：富士キメラ総研,JMS

1

2016年度 実績

2

2017年度 計画

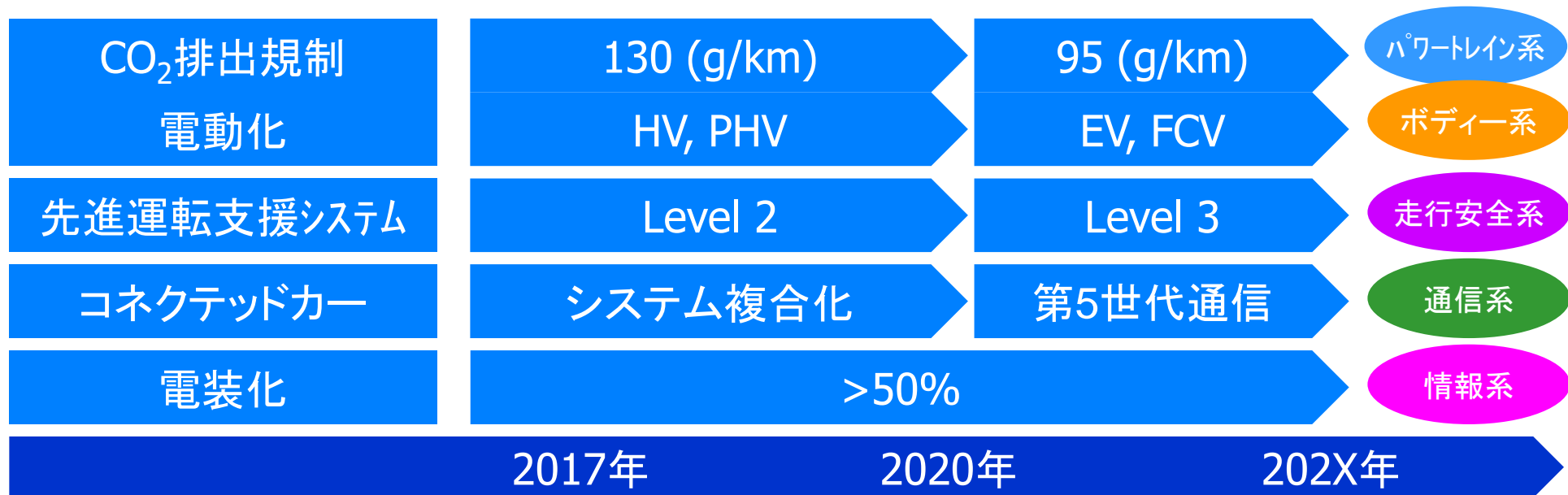
3

基板業界動向

4

技術ロードマップ

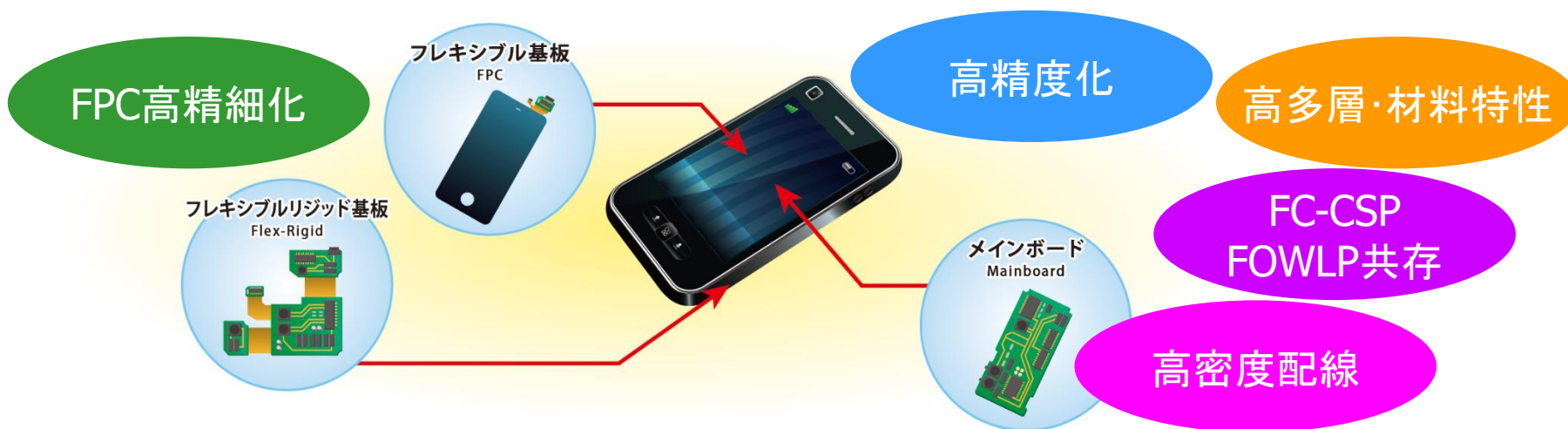
自動車 技術トレンド



車載用プリント配線板 技術ロードマップ

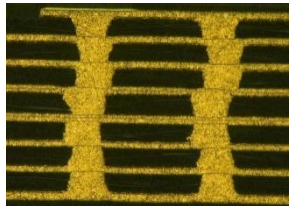
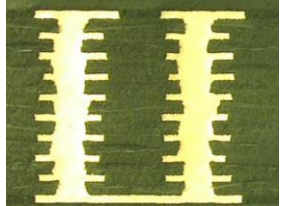
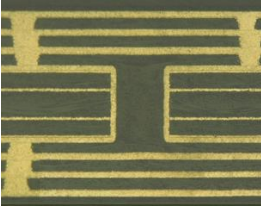



スマートフォン 技術トレンド

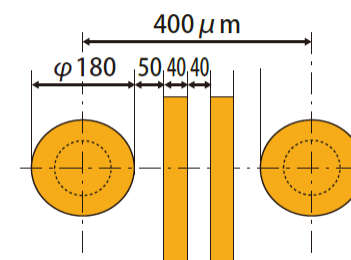


スマホメインボード 技術ロードマップ

電子部品	メインIC/サブIC	0.4/0.35mmピッチ	0.35/0.3mmピッチ	
高多層	フラッグシップ ミッドレンジ/ハイエンド	12層(5-2-5) 10層(2-6-2/3-4-3)	14層(6-2-6) 12層(3-6-3/4-4-4)	
材料特性	誘電率/耐熱性	Dk3.5/Tg170°C	Dk3.5/Tg190°C	
高密度配線	ライン幅/スペース ビア径/ランド径	L/S=40/40um 85/180um	L/S=30/40um 75/150um	
<スマホ技術>	<基板技術>	2017年	2019年	2021年

8層エニレイヤ 低誘電材(2013年)	10-12層エニレイヤ フラッグシップ(量産)	10層(3-4-3) ミッドレンジモデル	12層(4-4-4) ハイエンドモデル
			

メインIC搭載部 配線ルール





MEIKO

<http://www.meiko-elec.com/>

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績見通し等の計画・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの見通しは過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成した見通しです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は見通しと異なることがございます。